

# 岱陞科技遇見未來創新研討會

桃園場 - 9/4(二) 台灣電路板協會



親愛的業界先進：

隨著科技日新月異，面臨到的困難也與日遽增，誰能掌握未來，就能掌握先機，機械智能化已然成為發展趨勢，如何能在這競爭激烈的時代中脫穎而出呢？岱陞科技因應趨勢發展，為產業界推動達梭系統 3D 體驗解決方案，期望和業界先進一同在未來拔得頭籌，共創雙贏，提升企業價值及競爭力，2018 年 9 月 4 日，岱陞科技將於桃園舉辦遇見未來創新研討會，岱陞科技團隊與您分享交流最新技術解決方案與實務，誠摯的邀請您共襄盛舉！

岱陞科技股份有限公司  
達梭系統股份有限公司 敬邀

~~議程~~

- 13:00-13:30 來賓報到
- 13:30-13:40 致歡迎詞
- 13:40-14:20 CATIA 應用與新知
- 14:20-15:00 DELMIA 數位化製造解決方案
- 15:00-15:20 Tea Break
- 15:20-16:20 PowerBy & ENOVIA 設計配置協同管理
- 16:20-16:30 Q & A

報名方式：E - mail：[berry@uprise.com.tw](mailto:berry@uprise.com.tw) 網路報名：[www.uprise.com.tw](http://www.uprise.com.tw)

傳真報名：07-3350573

電話報名：07-3350570#12 黃小姐

研討會日期及地點：

桃園場日期：2018 年 9 月 4 日(二) / 地點：台灣電路板協會 4 樓 402 室(詳細地址如下)

## <研討會報名表>

<b>研討會名稱</b>	<b>2018 岱陞科技遇見未來創新研討會</b>		
公司/單位			
來賓姓名		聯絡電話	
E-mail 帳號			
研討會地點	桃園場次：9/4(二) 台灣電路板協會 4樓402室 地址：桃園市大園區高鐵北路二段147號 電話：03-3815659		
報名參加者，請填妥以上表格後傳真 07-335-0573 或 e-mail 至黃小姐 電話：07-335-0570 #12 <a href="mailto:berry@uprise.com.tw">berry@uprise.com.tw</a> 黃小姐			

◎停車格及步行路線

